

台灣發明商品促進協會 函

地址：105台北市松山區八德路二段400號7樓

承辦人：賴淑玲

電話：02-8772-3898#19

Email：wiipa168@wiipa.org.tw

受文者：國立中正大學

發文日期：中華民國112年6月26日

發文字號：台發學字第1120062603號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (1120062603_Attach1.docx、1120062603_Attach2.pdf)

主旨：敬邀 貴校師生參加「2023第10屆高雄國際發明暨設計展」。

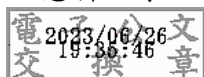
說明：

- 一、台灣發明商品促進協會，深耕台灣發明30載，集結專業團隊及掌控全球脈動，擅長整合跨國資源，有效提升參展效益。
- 二、「2023第10屆高雄國際發明暨設計展」將於112年11月30日至12月2日在高雄展覽館舉辦，敬邀 貴校師生參賽，請惠予公告並鼓勵相關人員踴躍參加。
- 三、早鳥報名加碼專案，補助「曼谷國際發明展」參展費。
- 四、即日起報名至112年10月15日止，洽詢專線(02)8772-3898分機19賴小姐或email至wiipa168@wiipa.org.tw。

正本：國立臺灣海洋大學、國立政治大學、國立臺灣大學、國立臺灣大學計算機及資訊網路中心、國立臺灣大學生物資源暨農學院附設山地實驗農場、國立臺灣大學生物資源暨農學院附設農業試驗場、國立臺灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院、國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處、國立臺灣師範大學、國立陽明交通大學、國立臺北藝術大學、國立臺北教育大學、臺北市立大學、東吳大學、中國文化大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、大同大學、臺北醫學大學、康寧學校財團法人康寧大學、國立臺灣戲曲學院、國立臺北護理健康大學、國立臺北商業大學、國立臺北大學、國立臺灣藝術大學、馬偕學校財團法人馬偕

醫學院、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、淡江大學學校財團法人淡江大學、華梵大學、真理大學、國立體育大學、國立中央大學、中原大學、長庚大學、元智大學、開南大學、國立清華大學、玄奘大學、中華大學學校財團法人中華大學、國立聯合大學、國立臺中教育大學、國立臺灣體育運動大學、國立中興大學、國立中興大學計算機及資訊網路中心、東海大學、逢甲大學、靜宜大學、中山醫學大學、亞洲大學、國立彰化師範大學、大葉大學、明道學校財團法人明道大學、建國科技大學、國立暨南國際大學、國立嘉義大學、國立中正大學、南華大學、稻江科技暨管理學院、國立臺南藝術大學、國立臺南大學、台灣首府學校財團法人台灣首府大學、中信學校財團法人中信金融管理學院、長榮大學、國立中山大學、國立高雄師範大學、國立高雄大學、義守大學、高雄醫學大學、國立屏東大學、國立金門大學、國立宜蘭大學、佛光大學、國立東華大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、國立臺東大學、國立空中大學、高雄市立空中大學

副本：



施養隆 會長

